

# 崇达技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行董事会职责。始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，全力维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会的主要工作内容报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

根据 Prismark 报告，2025 年，全球印制电路板（PCB）行业呈现稳步复苏态势，AI 算力基础设施投资持续扩大，新能源汽车智能化加速渗透，为高端 PCB 产品带来结构性增长机遇。全年全球 PCB 市场规模约 854 亿美元，同比增长 15.8%；中国 PCB 市场规模约 410.7 亿美元，中国大陆 PCB 市场产值同比增长 19.2%，增速位居全球各主要产区首位，占全球份额超过 50%，行业竞争格局进一步向技术驱动和价值链提升方向演进。

在此行业背景下，公司紧紧围绕年度经营目标，持续推进大客户营销战略，加速高端产能布局。报告期内，公司实现营业收入 75.44 亿元，同比增长 20.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，同比增长 25.73%。公司 2025 年度主要经营指标完成情况如下：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	7,543,700,533.02	6,277,145,221.58	20.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	323,973,349.38	257,663,884.03	25.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	319,318,676.06	270,880,536.83	17.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,318,287.76	449,218,779.72	-22.46%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.62%	0.57%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	12,643,799,191.39	12,311,486,642.87	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,856,776,918.47	7,172,153,290.57	23.49%

## 二、公司的核心竞争力分析

### （一）客户优势：储备丰富、均衡发展

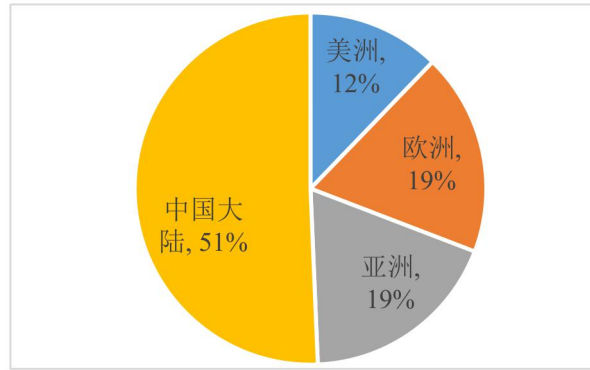
公司深耕 PCB 行业三十载，始终坚持以客户为中心的经营理念，致力于为客户提供高品质、高效率且具备成本优势的产品与服务，持续为客户创造最大化价值。依托对客户需求的深刻理解及长期陪伴客户共同成长的实践积累，公司形成了独特、高效的服务模式与快速响应机制，积淀了丰富且优质的境内外知名客户资源。

报告期内，公司荣获施耐德电气“2025 年优质合作供应商”、光峰科技“2024~2025 年度交付质量奖”及“最佳质量奖”、中兴通讯“最佳交付支持奖”、艾佳普“最有价值合作伙伴”、云尖信息“有效支持奖”、海康威视“优秀供应商”等多项荣誉，持续获得产业链核心客户的认可与信赖。

2025 年度，公司继续深入推进面向手机、电脑、汽车、通信、服务器五大重点行业的大客户销售策略。在手机及电脑领域，公司主要通过华勤、龙旗、天珑等客户间接服务于联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊等终端品牌，产品主要应用于手机主板、副板、模组以及电脑主板、内存、硬盘等关键部件。在通信领域，公司主要服务于中兴、烽火、康普、锐捷网络、Tejas、安费诺、Intel、艾默生等客户，产品主要应用于 5G 基站、收发信设备、线卡及交换机等通信基础设施。在服务器领域，公司主要客户涵盖中兴、新华三、云尖、浪潮、宝德等，产品广泛应用于超级计算机、服务器主板、存储设备及 GPU 等核心硬件，服务器相关订单呈现快速增长态势。在汽车电子领域，公司主要客户包括博世、弗瑞亚、LG 麦格纳、力高、耐世特、普瑞均胜、松下、泰科电子、伟世通、小鹏等，产品主要应用于电子驱动系统、中控系统、车身电子、智能驾驶、智能座舱及通信娱乐系统等，业务布局持续深化。

报告期内，公司持续完善市场多元化布局，客户区域结构进一步优化，已形成以中国大陆市场为战略支点、海外市场均衡覆盖的销售格局，有效分散了单一区域市场波动带来的经营风险。2025 年度，公司实现中国大陆地区销售收入占比 51%，欧洲、亚洲（不含中国大陆）、美洲市场收入占比分别为 19%、19%及 12%，各区域收入占比均处于合理区间，未对单一区域市场形成重大依赖。

公司通过深化与境内外重点行业客户的战略合作、稳步拓展新兴市场客户群体，构建了多元化、均衡化的客户生态体系，进一步增强了公司的抗风险能力与经营韧性，为公司长期稳健、可持续发展奠定了坚实基础。



(2025 年度区域销售收入结构图)

## (二) 产品优势：全产品线布局且产品结构不断优化升级，高多层板、HDI 板、IC 载板等高端板产品稳步提升

随着 5G 通信、人工智能、云计算、智能网联汽车等下游应用领域的快速发展，高端印制电路板（PCB）的市场需求持续旺盛，行业呈现向高多层、高密度互连（HDI）、高频高速及封装基板方向加速演进的趋势。公司凭借深厚的技术积淀与规模化制造能力，经过多年发展与积累，在产品技术先进性、品牌市场认可度、优质客户资源储备、精细化成本管控及全流程质量控制等方面构建了独特的综合竞争优势，已成为国内领先的 PCB 制造企业之一，具备规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力。

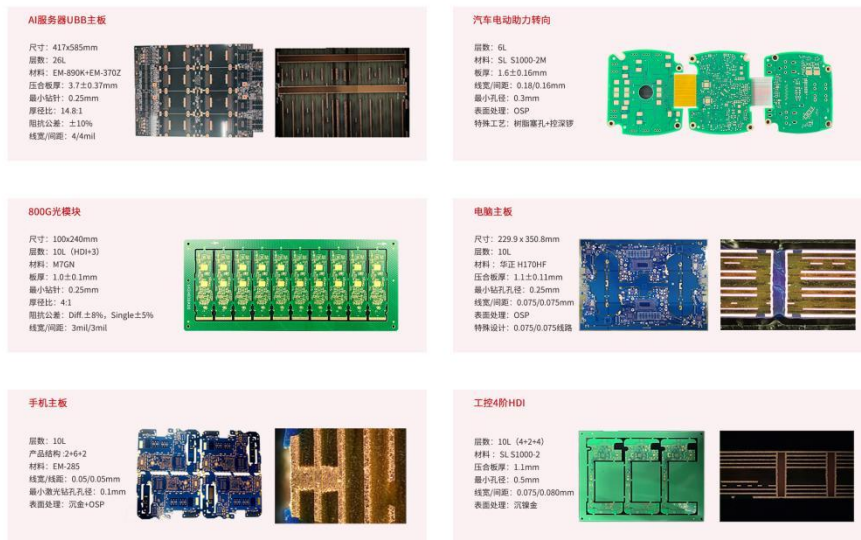
公司产品类型覆盖全面，涵盖高多层板、HDI 板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板及 IC 封装基板等，广泛应用于通信设备、服务器与数据中心、智能手机、个人电脑、汽车电子、工控医疗等众多领域，能够充分满足不同层次、不同应用场景客户的多样化需求。其中，高多层板最高量产层数已达 68 层，具备大容量服务器主板及高速背板的制造能力；HDI 板量产能力覆盖 1-5 阶 HDI 板，广泛应用于智能手机主板及加速卡；IC 载板方面，子公司普诺威已实现 MEMS 传感器封装基板、射频滤波器封装基板及 SiP 系统级封装基板的量产，最小线宽/线距能力达到  $12\ \mu\text{m}/12\ \mu\text{m}$ ，具备先进封装领域的核心竞争力。

高端 PCB 市场具有较高的准入门槛，主要体现在核心技术工艺难度大、设备投入与资金占用规模高、客户认证周期长以及多品种规模化生产管理复杂等多重壁垒。公司持续推动产品结构优化升级，坚定执行“高端板占比提升”战略，不断扩大高附加值产品的市场份额。报告期内，公司高多层板、HDI 板、IC 载板等高端产品合计收入占比已提升至 60% 以上，产品附加值及整体市场竞争力持续增强。

为把握行业发展的战略机遇期，进一步巩固高端产能优势，公司通过非公开发行股票方式向特定对象募集资金 20 亿元，专项用于珠海崇达二期项目建设。该项目聚焦于高多层板、

HDI 板、软硬结合板等高端 PCB 产品的规模化生产，主要面向通信网络、服务器、智能手机、电脑等快速增长的下游市场，是公司实现产能结构跃升的核心战略举措。截至 2025 年末，珠海崇达二期（含珠海二厂及三厂）两座新厂房已完成主体建设，其中珠海二厂产线已于 2024 年 6 月陆续投产，新增高多层板月产能 12 万平方米，有效缓解了公司在服务器、通信领域高端产品的产能瓶颈。

展望 2026 年，随着珠海崇达二期各产线的陆续投产及产能爬坡，以及控股子公司普诺威 SiP 封装基板事业部一期产能的持续释放，公司在高端 PCB 及先进封装基板领域的产能储备将实现跨越式提升，为公司参与算力基础设施、智能汽车电子及下一代通信设备等新兴市场的竞争提供坚实的产能保障，有力支撑公司中长期高质量发展战略目标的实现。



### （三）研发优势：知识产权数量行业领先，IC 载板突破先进封装制程

公司始终将技术研发作为可持续发展的核心驱动力，持续完善研发管理体系，建立了覆盖多层板、HDI 板、封装基板等各产品线的工程技术数据库，能够有效响应不同层级客户的差异化技术需求。在推动技术全面发展的同时，公司在高速高频材料应用、大尺寸拼版工艺、先进封装基板制程等细分领域取得系列技术成果，形成了一批具有自主知识产权的核心技术。

在知识产权与标准制定成果方面。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利 296 项，其中发明专利 261 项、实用新型专利 35 项，另拥有计算机软件著作权 29 项。报告期内新增专利申请 45 项，其中发明专利申请 40 项、实用新型专利申请 5 项，发明专利在新申请专利中的占比为 88.89%。公司积极参与行业标准体系建设，以第一起草单位身份修订的 1

项国家标准于报告期内正式发布。同时，公司持续推进与国内高等院校的产学研合作，促进前沿技术研发与产业化应用的有效衔接。

在科技荣誉与项目评价方面。2025 年度，公司获评“人工智能（AI）芯片用高阶任意层互连印制电路板”“112Gbps 交换机用印制电路板”“800G 高速光模块印制电路板”“智慧安防用半挠性印制电路板”4 项广东省名优高新技术产品。完成科技成果评价 3 项，评价结论均为国内领先水平；完成科技成果登记 3 项。2025 年内荣获广东省制造业单项冠军、广东省智慧安防印制电路板工程技术研究中心、粤港澳大湾区人工智能与自动化学会科技进步奖、江门市高价值专利培育布局大赛金奖、江门科学技术奖科技进步奖等多项科技类荣誉。

在研发投入与重点技术进展方面。2025 年，公司研发费用投入 3.68 亿元，同比增长 6.41%。报告期内，公司围绕算力基础设施、高速通信网络、智能显示终端等下游应用领域的技术需求，完成多项关键技术开发工作，主要包括：AI 芯片用高阶任意层互连印制电路板研发及产业化、大尺寸 PCB 熔铆合预叠一体化压合技术研发、112G 通讯电路板制作关键技术开发、AI 服务器 UBB 主板用印制电路板技术研发、高清晰 LED 显示屏用印制电路板技术研发、提高信号传输速率的射频封装基板研发等。其中，112G 高速电路板已完成客户认证并进入批量交付阶段。

在 2026 年度重点研发方向方面。2026 年，公司将继续围绕通信网络设备、智能驾驶系统、工业自动化、低空经济等下游应用领域的技术演进方向，重点开展以下研发工作：高多层厚铜电源板产品开发、通信基站 AAU 模块高频印制电路板产品开发、高速光模块印制电路板关键技术研究、高可靠工业机器人专用刚挠结合印制电路板研发、低空智能无人机高集成度印制电路板关键技术研究、高密度埋铜块 PCB 生产技术研究、提高信号传输速率的射频封装基板研发、12  $\mu\text{m}$ /12  $\mu\text{m}$  超精细线路封装基板研发、高可靠性系统级封装基板研发及高精度高集成密度封装基板研发等。

在先进封装基板技术能力方面。控股子公司普诺威专注于封装基板业务，以 MEMS 封装基板为基础，已拓展至 Sensor、射频滤波器等产品领域，并逐步向 PA、SiP 等先进封装基板方向延伸。普诺威 SiP 封装基板事业部一期产线已实现通产，采用 mSAP（改良型半加成工艺）、ETS（嵌入式线路结构）及超微孔等工艺技术，Trace Pitch（线路间距）能力达到 25  $\mu\text{m}$ ，最小成品板厚量产能力为 0.11mm，具备平面嵌入式电容、嵌入式电阻、芯片嵌入与半嵌入等工艺能力。

在技术资质与平台认定方面。公司荣膺国家级知识产权示范企业。子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、珠海崇达、大连电子及普诺威均为高新技术企业。其中，深圳崇达被列

为国家火炬计划重点高新技术企业，并被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），其实验室持有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可证书及 NADCAP 认证；江门崇达被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心及广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。

#### （四）管理优势：PCB 智能制造领先企业，创新工段管理标准化

公司持续深化信息化与工业化融合，构建了覆盖集团全业务链条的数字化管理体系。通过与 IBM、Oracle 等企业开展合作，公司建立了 ERP 系统和智能柔性生产线，为管理精细化与生产自动化提供了系统化的 IT 架构和流程支撑。近年来，公司持续推进智能设备更新迭代、机器替代人工的技术改造以及生产流程的优化重组，在 PCB 智能制造领域形成了一定的先发优势。

2025 年度，公司进一步加大智能制造系统建设投入，与西门子、赛意等供应商合作部署制造执行系统（MES），实现了生产过程的可视化管控，能够对生产进度、设备运行状态进行实时监控与调度，为生产效率提升与质量一致性保障提供了数据支持。通过设备自动化互联平台（EAP），公司实现了主要生产设备的互联互通与运行数据共享，增强了工序间的协同性，有助于减少设备等待时间与生产资源浪费。在质量管理环节，公司依托质量管理体系（QMS）构建了覆盖产品全生命周期的质量数据采集、分析与追溯体系，能够对质量异常进行精准定位与闭环处理，助力产品一次良率提升与报废率压降。

工段管理标准化是公司在 PCB 制造管理领域的一项系统性管理创新实践。公司依据 PCB 生产工艺流程特点，将原有的十余个主要生产工序进一步细分为百余个标准化工段，针对每个工段独立开展成本核算，并围绕设备参数、物料消耗、人工工时、费用分摊、工艺规程及标准作业时间等要素建立量化标准。通过工段级的精细化管理，公司在品质一致性、交付准时率及成本控制等维度实现了管理颗粒度的显著细化，有效降低了多品种、大批量生产模式下的管理复杂度，为运营效益的持续优化提供了可复制的管理工具。

#### （五）生产优势：各工厂协同发展，珠海两座新厂房已建设完成，布局海外生产基地

为优化集团整体资源配置、提升对客户多样化产品需求的响应效率，公司对下属各子公司实施差异化的产品分工定位，构建了覆盖不同产品类型与应用领域的产能矩阵。江门崇达一厂重点面向工控、汽车电子、电子制造服务（EMS）、医疗等下游市场，承担大批量 PCB

产品的制造任务；江门崇达二厂主要定位于高密度互连板（HDI）、软硬结合板及薄板等高端 PCB 产品，产品主要应用于手机、LED 显示及平板电脑等领域；珠海崇达一厂聚焦汽车电子、光电显示及手机等下游领域的大批量 PCB 产品；珠海崇达二厂则以服务器、通信设备、航空航天及医疗等领域的高多层 PCB 产品为主要方向；大连崇达延续多品种、小批量的生产模式，为集团客户提供一站式的差异化产品服务；控股子公司普诺威专注于 IC 载板及内埋器件系列封装基板的生产，产品应用于消费电子、工控电子及汽车电子等市场。

通过上述分工布局，公司对各工厂在采购渠道、客户资源、生产技术及管理经验等方面进行统筹协调，推动工厂间的资源共享与协同运作，有助于降低综合生产成本与运营费用，提升集团整体的生产运营效率。

珠海崇达生产基地是公司近年来产能建设的重点区域。珠海崇达项目规划用地面积 400 亩，设计年产能为 640 万平方米电路板，计划分期建设三座工厂。其中，珠海崇达一厂于 2021 年第二季度启动试产，2022 年第四季度第二条产线实现通产，主要面向光电、汽车、电脑类等 PCB 产品，目前产能处于持续爬坡阶段。

2025 年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目——珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）两座工厂已完成主体建设。珠海崇达二厂已于 2024 年 6 月陆续投产，新增高多层 PCB 板月产能 12 万平方米，主要面向服务器、通信设备等应用领域。随着珠海崇达二期各产线的陆续投产与产能逐步释放，预计将为公司整体产能扩充与产值提升提供增量支撑。



（珠海崇达实景图）

印制电路板行业具有国际化充分竞争的特征。公司基于长期发展战略，结合境外客户对供应链区域化服务的实际需求，稳步推进海外生产基地布局。2025 年 8 月，公司完成泰国子公司（泰国崇达）的设立登记手续，并取得面积为 70 莱（折合约 112,000 平方米）的工业用地作为泰国工厂建设用地。2025 年 9 月，泰国崇达工厂在泰国巴真府洛加纳工业园举

行奠基仪式。截至 2025 年 11 月 25 日，泰国崇达已通过泰国投资促进委员会（BOI）的审批，注册资本增至 10 亿泰铢。泰国工厂占地面积约 168 亩，项目规划分两期建设，首期投资规模约为 10 亿元人民币，建成后将具备高多层板及高阶 HDI 板等产品的制程能力，主要服务于通信、服务器等领域的境外客户。

此次境外投资是公司在主营业务范围内，基于业务发展实际需要及全球化战略布局所实施的重要举措，有利于公司进一步拓展境外市场、完善全球供应体系，符合公司长期发展的战略方向。



（泰国崇达设计效果图）

### 三、2025 年公司董事会开展的主要工作

#### （一）董事会召开情况

2025 年，共召开了 6 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 15 日	1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》； 8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

序号	届次	召开时间	议案内容
			案》； 11、《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 12、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》； 14、《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》； 15、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 16、《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》； 17、《关于公司质量回报双提升行动方案的议案》； 18、《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》。
2	第五届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 25 日	1、审议《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》。
3	第五届董事会第二十四次会议	2025 年 8 月 20 日	1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4	第五届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 22 日	1、审议《关于提前赎回“崇达转 2”的议案》。
5	第五届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 29 日	1、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》； 3、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》； 4、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 6、审议《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》； 7、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 8、审议《关于<未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划>的议案》； 9、审议《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 10、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会第一次会议	2025 年 11 月 28 日	1、审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

## （二）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会的有关决议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
----	----	------	------

序号	届次	召开时间	议案内容
1	2024 年度股东会	2025 年 5 月 9 日	1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 6.00 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 7.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.00 《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 9.00 《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》 10.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 11 月 28 日	1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 1.01 选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事 1.03 选举余忠先生为第六届董事会非独立董事 2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 2.01 选举王东民先生为第六届董事会独立董事 2.02 选举张建军先生为第六届董事会独立董事 2.03 选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事 3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 5.00 《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》 6.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 6.01 修订《股东会议事规则》 6.02 修订《董事会议事规则》 6.03 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 6.04 修订《独立董事工作条例》 6.05 修订《累积投票制度实施细则》 6.06 修订《对外担保管理制度》 6.07 修订《对外投资管理制度》 6.08 修订《募集资金管理制度》 6.09 修订《关联交易管理制度》 6.10 修订《信息披露管理制度》 7.00 《关于<未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划>的议案》

### （三）专门委员会工作情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要

的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为，公司内控制度体系符合法律法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

## 2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## 3、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司独立董事的薪酬情况、股权激励限制性股票方案及授予等情况进行了审核，认为独立董事薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，股权激励能够充分调动公司及控股子公司核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

## 4、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作条例》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权利，积极出席相关会议，深入了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2025 年度述职报告。

### （五）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，严格履行上市公司信息披露义务。2025 年，公司累计公开披露 170 份文件，其中 89 份公告文件、81 份其他文件。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。

公司通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2025 年度，公司通过投资者热线积极回答投资者，通过深交所互动易回复中小投资者提问 323 次，举办业绩说明会 3 场，接受中信证券等机构集中调研，通过充分沟通，使投资者对公司的竞争优势、发展规划等有了更为深刻的认知。

#### **（六）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的规定，在年度报告、半年度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及短线买卖公司股票的行为。

### **四、2026 年工作计划**

2026 年，公司董事会将严格依据《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营状况与发展战略，围绕规范治理、合规运营及战略落地等重点领域，统筹推进以下工作：

#### **（一）持续提升董事会规范运作水平**

董事会将继续严格履行信息披露义务，确保披露信息的真实性、准确性、完整性与及时性。持续加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台回复等多种方式，保障投资者获取公司信息的渠道畅通。董事会将在股东会授权范围内审慎行使决策权，认真落实股东会各项决议，并对经营管理层的执行情况进行动态跟踪与评估，推动公司治理水平稳步提升。

## （二）强化中小投资者合法权益保护机制

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会、深圳证券交易所发布的配套规则要求，将中小投资者权益保护工作纳入公司治理的常态化机制。重点保障中小股东在公司重大事项决策中的知情权、参与权与表决权，持续优化利润分配政策的稳定性与可预期性，切实回应中小投资者合理关切。

## （三）完善内部控制体系与风险管理

董事会将督导管理层持续健全内部控制制度，结合行业监管政策变化及公司业务发展实际，对现有内控流程进行动态评估与优化。重点关注募集资金使用管理、关联交易决策程序、对外担保审批及财务报告内部控制等关键环节，确保公司各项经营活动在合规框架内有序运行。审计委员会将加强对内控执行情况的监督检查，推动内控缺陷的及时识别与整改。

## （四）推动经营计划有效落地，保障公司稳健可持续发展

2026 年度，公司将围绕全球化产能布局与高端产品结构优化两大主线，推进以下经营重点：

第一，深化大客户战略，优化订单结构。坚持以市场为导向、以客户为中心，持续聚焦通信、服务器、汽车电子、智能手机等重点行业的头部客户，完善大客户服务流程与交付保障机制，稳步提升中大批量订单占比。同时，加强对订单盈利能力的动态评估，持续优化产品结构与客户组合。

第二，加大研发投入力度，提升高端产品技术竞争力。围绕算力基础设施、5G/6G 通信网络及智能网联汽车等应用方向，重点推进高阶任意层互连 PCB、112G/224G 高速通信电路板及先进封装基板等前沿技术研发，推动高端产品收入占比进一步提升。持续强化产品品质管控，降低客户投诉率与内部报废率，以技术能力与品质水平巩固市场竞争地位。

第三，深化精细化运营管理，提升成本效率优势。持续推进工段独立核算管理模式，落实成本管控责任到人，推动大拼板工艺、机器替代人工及智能制造系统的深度应用，进一步降低单位制造成本，提升资产运营效率。

第四，有序推进产能项目建设，保障交付能力。加快珠海崇达二期各产线的产能爬坡进度，合理规划大连崇达二期项目建设节奏，确保新增产能与市场需求有效匹配。同时，统筹协调各工厂产能资源，提升集团整体交付弹性与响应速度。

第五，稳步实施海外生产基地建设。按计划推进泰国崇达一期项目建设，力争于 2026 年内完成主体厂房建设及主要生产设备安装，逐步具备试产条件，为服务境外客户及完善全球供应链布局提供产能支撑。

回顾 2025 年，公司董事会在各位股东的支持与配合下，较好地履行了各项职责。展望 2026 年，全球 PCB 产业仍处于结构性调整与技术升级的关键阶段，公司面临的市场机遇与经营挑战并存。董事会将继续秉持审慎决策、科学统筹的工作原则，积极应对内外部环境变化，推动公司各项经营目标顺利达成，努力以稳健的经营业绩回报全体股东的信任与支持。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日